

# 2020年3月期（2019年4月～2020年3月） 東京エレクトロン 決算説明会

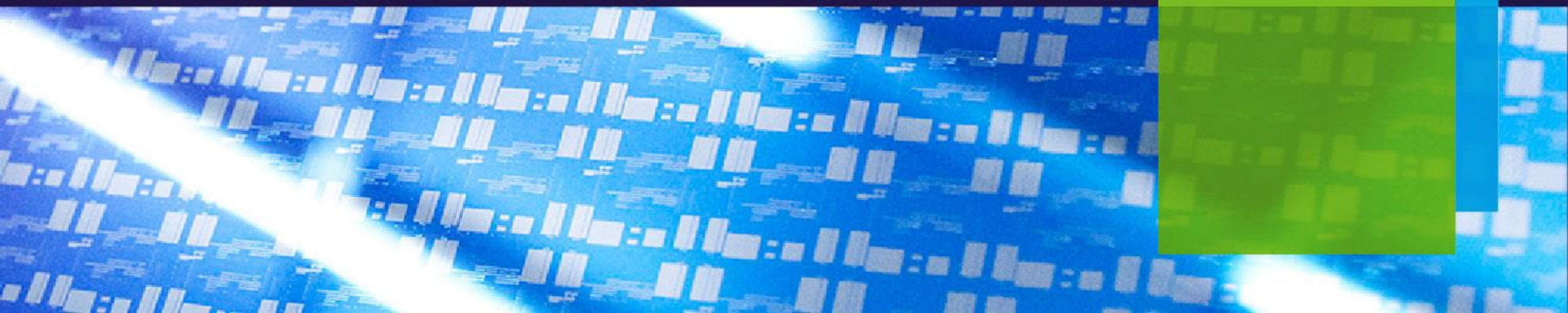
2020年4月30日

内容：

- 2020年3月期 連結決算の概要
- 事業環境

取締役 専務執行役員  
代表取締役社長・CEO

布川 好一  
河合 利樹



# 将来予想等に関する記述

- 将来見通しについて

本資料に記述されている当社の事業計画、将来予測などは、当社が作成時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、経済情勢、半導体/FPD市況、販売競争の激化、急速な技術革新への当社の対応力、安全・品質管理、知的財産権に関するリスク、新型コロナウイルスの影響など、さまざまな外部要因・内部要因の変化により、実際の業績、成果はこれら見通しと大きく異なる結果となる可能性があります。

- 数字の処理について

記載された金額は単位未満を切り捨て処理、比率は1円単位の金額で計算した結果を四捨五入処理しているため、内訳の計が合計と一致しない場合があります。

- 為替リスクについて

当社の主力製品である半導体製造装置及びFPD製造装置の輸出売上は、原則円建てでおこなわれます。一部にドル建ての決済もありますが、受注時に個別に先物為替予約を付し、為替変動リスクをヘッジしています。したがって、収益への為替レート変動による影響は極めて軽微です。

FPD：フラットパネルディスプレイ

# 2020年3月期 連結決算の概要

2020年4月30日

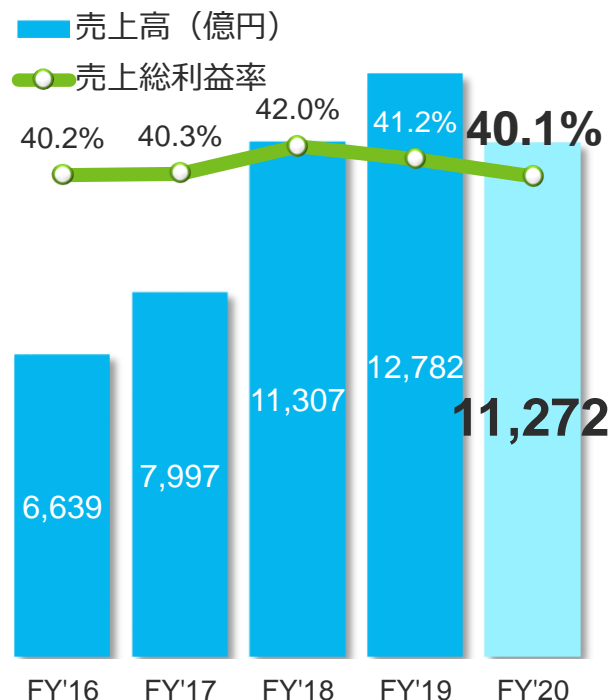
布川 好一

取締役 専務執行役員 ファイナンス本部長

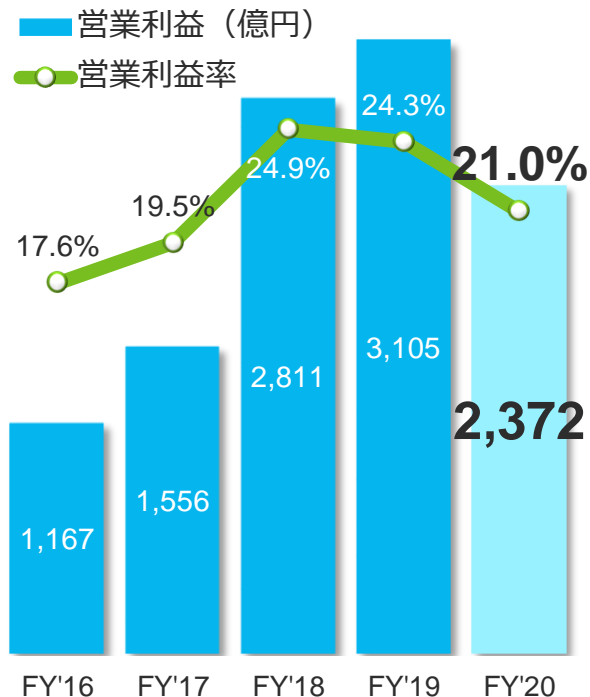


# FY2020（2019年4月～2020年3月）ハイライト

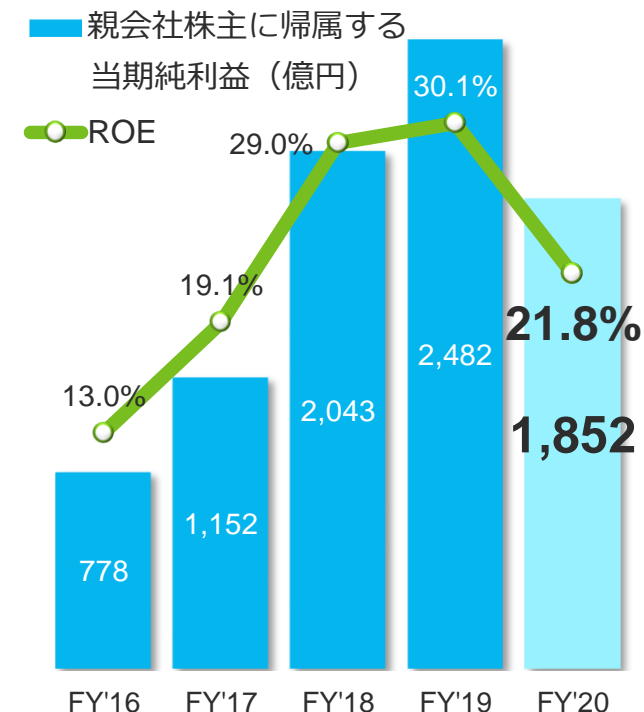
## 売上高と売上総利益率



## 営業利益と営業利益率



## 親会社株主に帰属する 当期純利益とROE



- SPE\*1およびFPD\*2設備投資の調整の影響を受け、売上が減少したが、市場成長に対応するために成長投資を継続
- 下方柔軟性への取り組みの成果が出て、収益性を維持できた

## FY2020（2019年4月～2020年3月）ハイライト

- 2019年5月末から2019年12月末にかけて自己株式を取得
  - 取得した株式の総数：8,392,000株
  - 取得価額の総額：149,999,373,492円
- 取得した自己株式のうち、8,000,000株を消却
  - 消却前の発行済株式の総数に対する割合：4.84%
  - 消却後の発行済株式の総数：157,210,911株
  - 取得数との差分の392,000株は、新株予約権（株式報酬型ストックオプション）に使用予定

# 損益状況

(億円)

|                     | FY2019         | FY2020         | 対前年<br>増減率        | (ご参考)<br>2019年10月31日発表<br>のFY2020予想 |
|---------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------------------------|
| 売上高                 | 12,782         | 11,272         | -11.8%            | 11,100                              |
| SPE                 | 11,667         | 10,609         | -9.1%             | 10,350                              |
| FPD                 | 1,112          | 660            | -40.6%            | 748                                 |
| 売上総利益<br>下段：売上総利益率  | 5,261<br>41.2% | 4,519<br>40.1% | -14.1%<br>-1.1pts | 4,450<br>40.1%                      |
| 販管費                 | 2,156          | 2,146          | -0.4%             | 2,200                               |
| 営業利益<br>下段：営業利益率    | 3,105<br>24.3% | 2,372<br>21.0% | -23.6%<br>-3.3pts | 2,250<br>20.3%                      |
| 税金等調整前当期純利益         | 3,215          | 2,446          | -23.9%            | 2,290                               |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益 | 2,482          | 1,852          | -25.4%            | 1,700                               |
| 1株当たり当期純利益 (円)      | 1,513.58       | 1,170.57       | -22.7%            | 1,074.47*                           |
| 研究開発費               | 1,139          | 1,202          | +5.5%             | 1,230                               |
| 設備投資額               | 497            | 546            | +9.9%             | 560                                 |
| 減価償却費               | 243            | 291            | +19.7%            | 330                                 |

1. 当社の主力製品である半導体製造装置およびFPD製造装置の輸出売上は、原則円建てでおこなわれます。一部にドル建ての決済もありますが、受注時に個別に先物為替予約を付し、為替変動リスクをヘッジしています。
2. 利益率および増減率は、1円単位の金額をもとに計算しています。
3. 1株当たり当期純利益の予想は、2020年1月30日発表

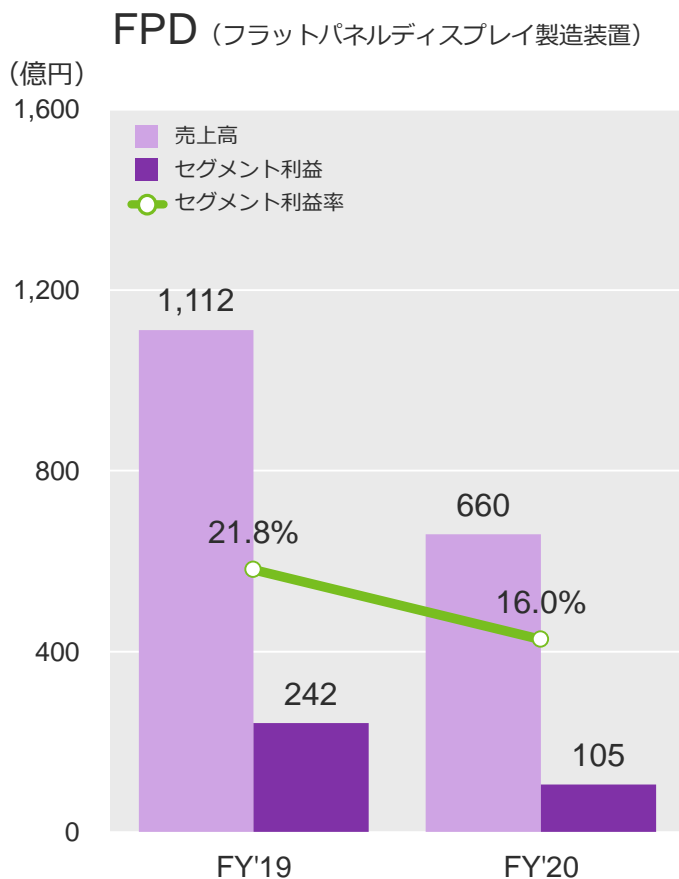
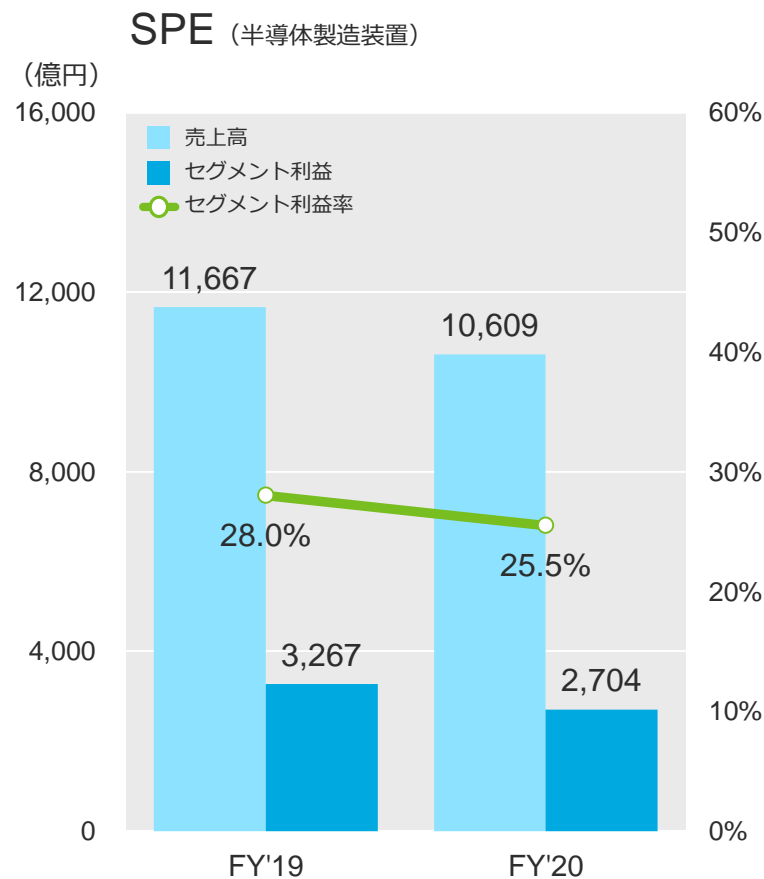
# 損益状況（四半期）

(億円)

|                     | FY2019 | FY2020 |       |       |       | 対FY2020 Q3<br>増減率 |
|---------------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------------------|
|                     | Q4     | Q1     | Q2    | Q3    | Q4    |                   |
| 売上高                 | 3,190  | 2,164  | 2,920 | 2,954 | 3,233 | +9.5%             |
| SPE                 | 2,887  | 1,981  | 2,718 | 2,820 | 3,089 | +9.6%             |
| FPD                 | 301    | 182    | 201   | 133   | 143   | +7.5%             |
| 売上総利益               | 1,322  | 898    | 1,146 | 1,175 | 1,298 | +10.5%            |
| 下段：売上総利益率           | 41.5%  | 41.5%  | 39.3% | 39.8% | 40.2% | +0.4pts           |
| 販管費                 | 558    | 473    | 547   | 528   | 597   | +13.0%            |
| 営業利益                | 764    | 425    | 599   | 647   | 701   | +8.4%             |
| 下段：営業利益率            | 24.0%  | 19.7%  | 20.5% | 21.9% | 21.7% | -0.2pts           |
| 税金等調整前当期純利益         | 798    | 445    | 620   | 646   | 733   | +13.5%            |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益 | 641    | 318    | 468   | 493   | 571   | +15.9%            |
| 研究開発費               | 300    | 256    | 312   | 298   | 334   | +12.0%            |
| 設備投資額               | 149    | 76     | 220   | 132   | 117   | -10.9%            |
| 減価償却費               | 73     | 60     | 67    | 76    | 86    | +12.4%            |

1. 当社の主力製品である半導体製造装置およびFPD製造装置の輸出売上は、原則円建てでおこなわれます。一部にドル建ての決済もありますが、受注時に個別に先物為替予約を付し、為替変動リスクをヘッジしています。
2. 利益率および増減率は、1円単位の金額をもとに計算しています。

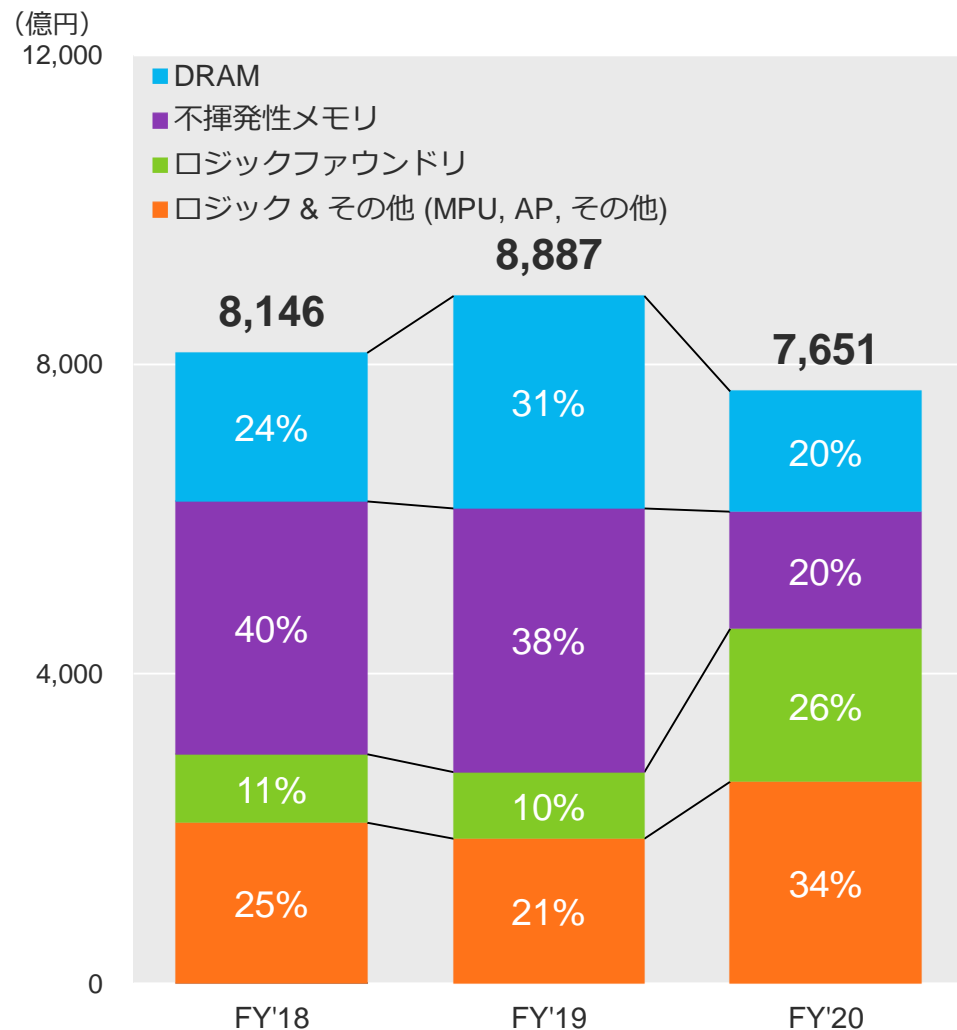
# セグメント情報



1. セグメント利益は、税金等調整前当期純利益です。
2. 上記報告セグメントに配分していない全社費用（主に基礎研究又は要素研究等の研究開発費）があります。
3. 売上構成比率は外部顧客に対する売上高で算出しています。

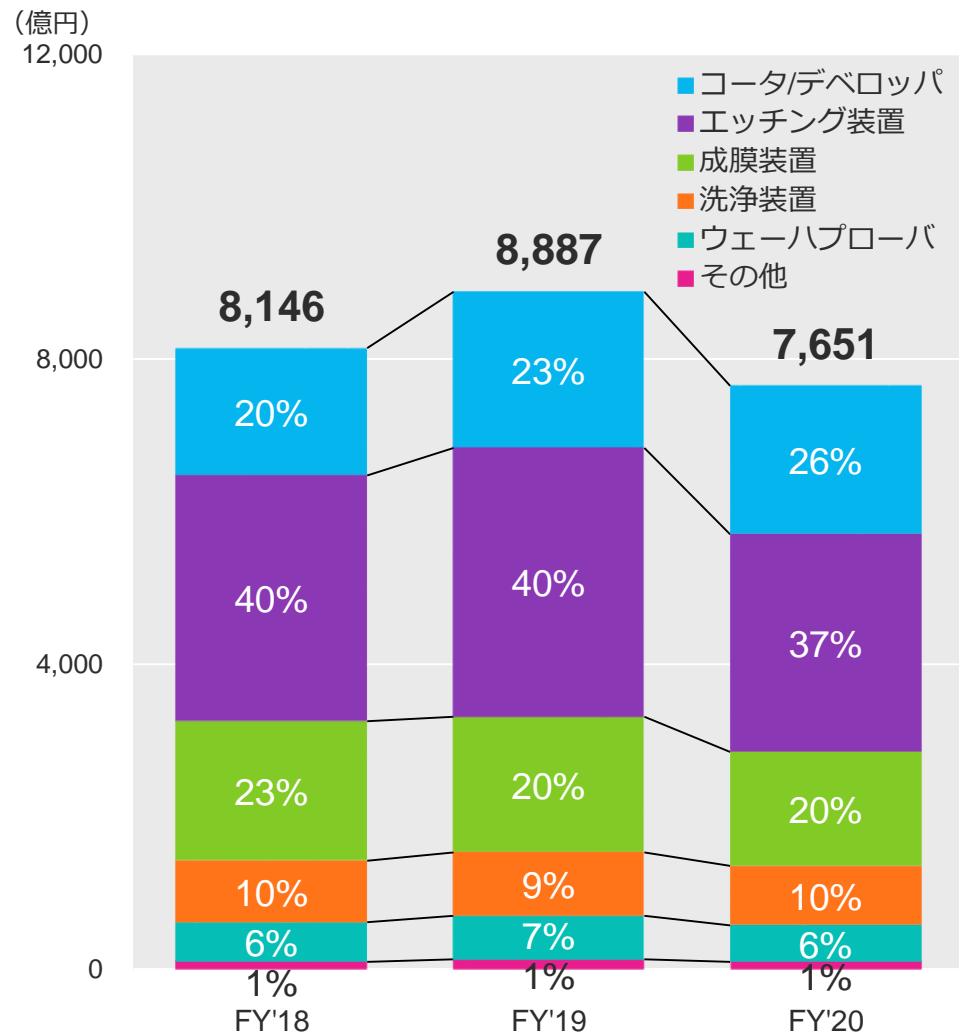


# SPE部門 新規装置 アプリケーション別売上構成比



- ロジック/ファウンドリにおいて、データセンターや5G対応のスマートフォン向けの高性能プロセッサの需要増に伴い、最先端世代の生産能力増強への投資増大が売上に大きく貢献
- メモリでは、過去数年に渡る生産能力増強が一服し、投資は調整局面となった

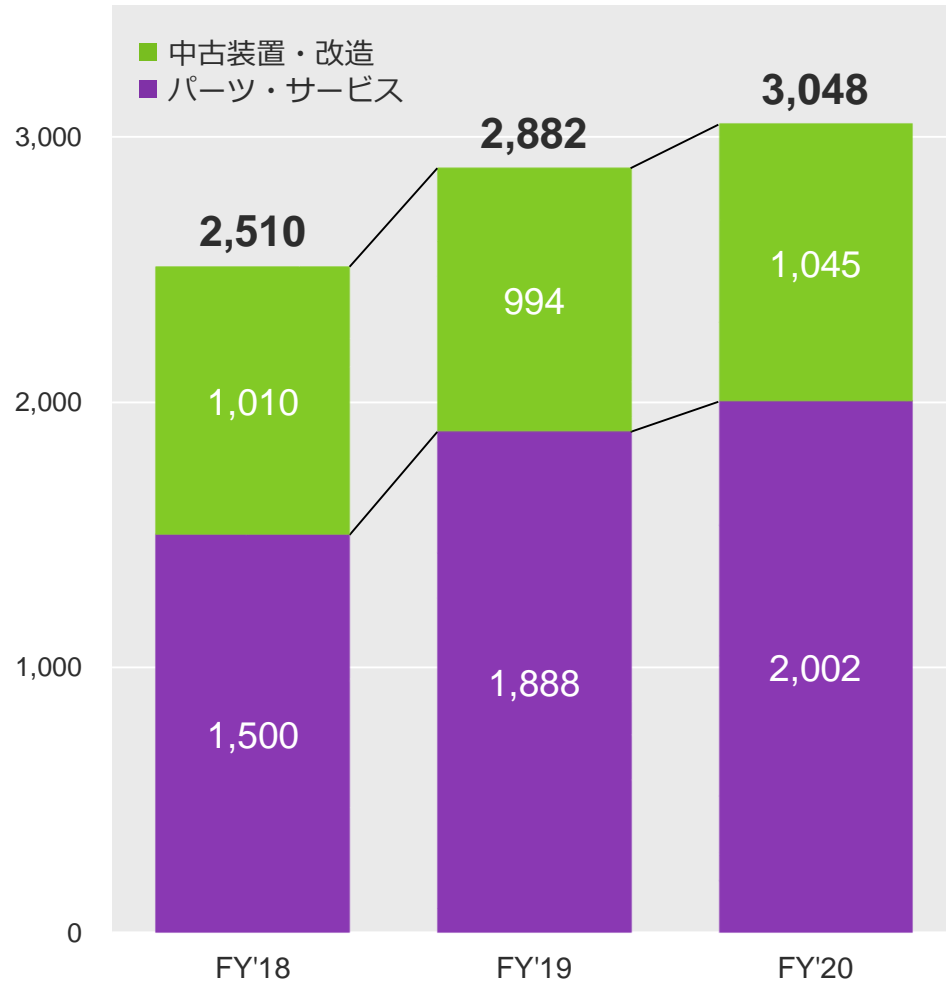
# SPE部門 新規装置 製品別売上構成比



- 最先端ロジック/ファウンドリ向け投資の構成比が増加し、不揮発性メモリ向けが減少したため、コータ/デベロッパの売上構成比が増加
- パワーデバイスやディスクリートなど成熟世代への投資比率の上昇に伴い、エッチング装置の売上構成比が減少

# フィールドソリューション売上高

(億円)

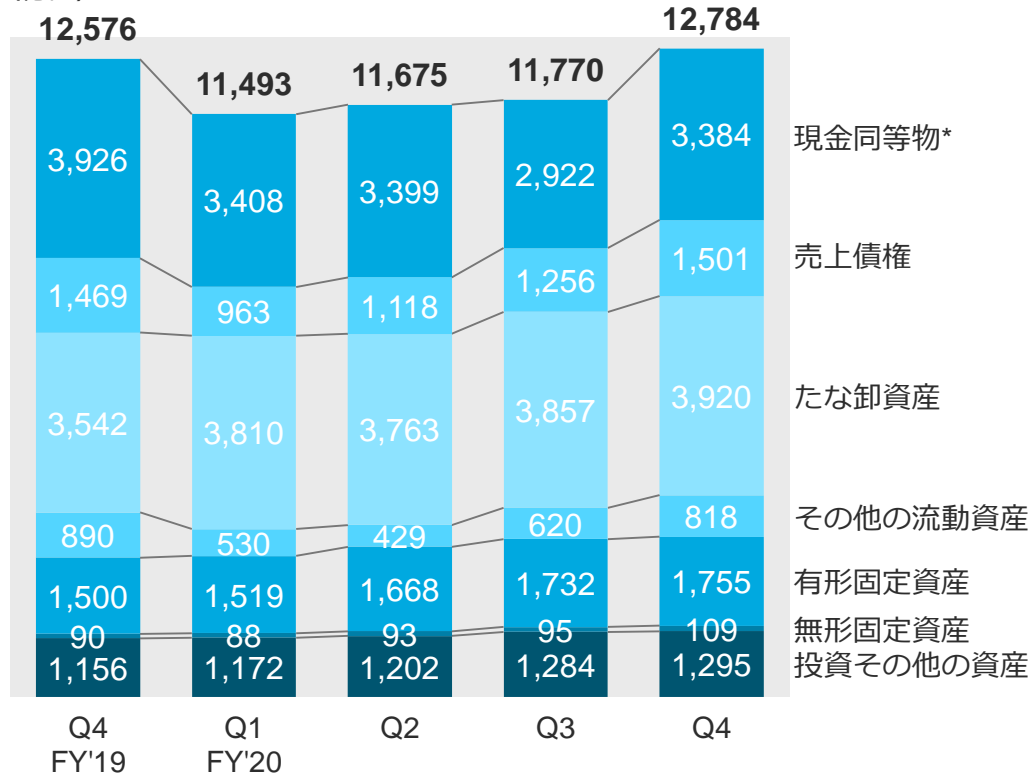


- FY2020は、フィールドソリューションの売上高は、前期比5.7%増加の3,048億円
- インストールベースの増加と顧客の高い稼働率によるパーツ・サービスの売上は堅調。顧客が資産を有効活用できる中古装置や改造ビジネスも増加

# 貸借対照表（四半期）

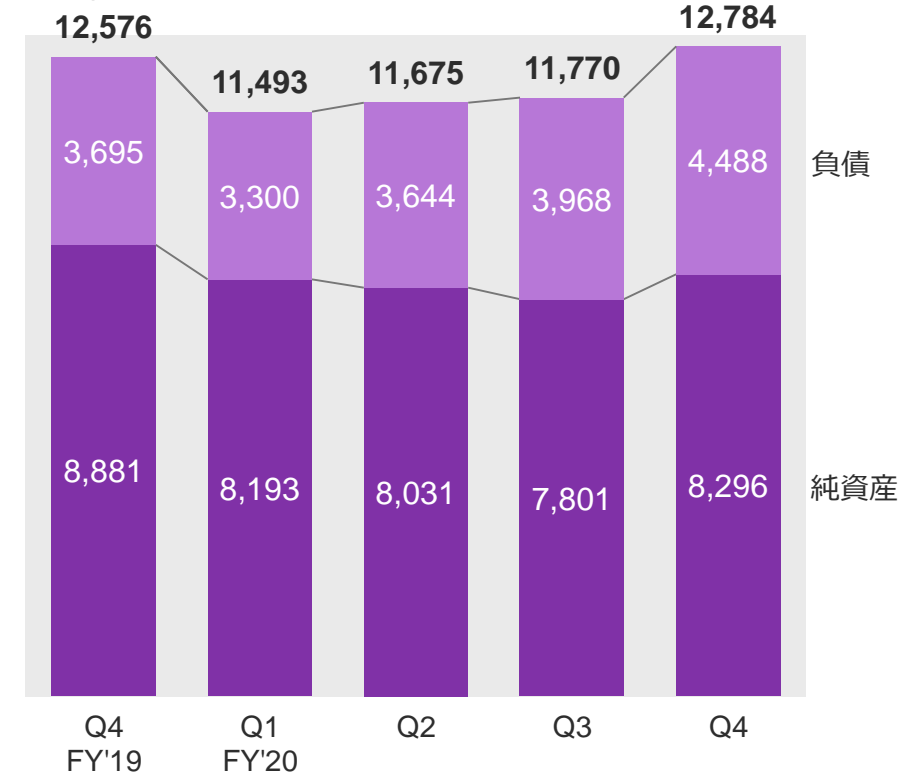
## 資産

(億円)

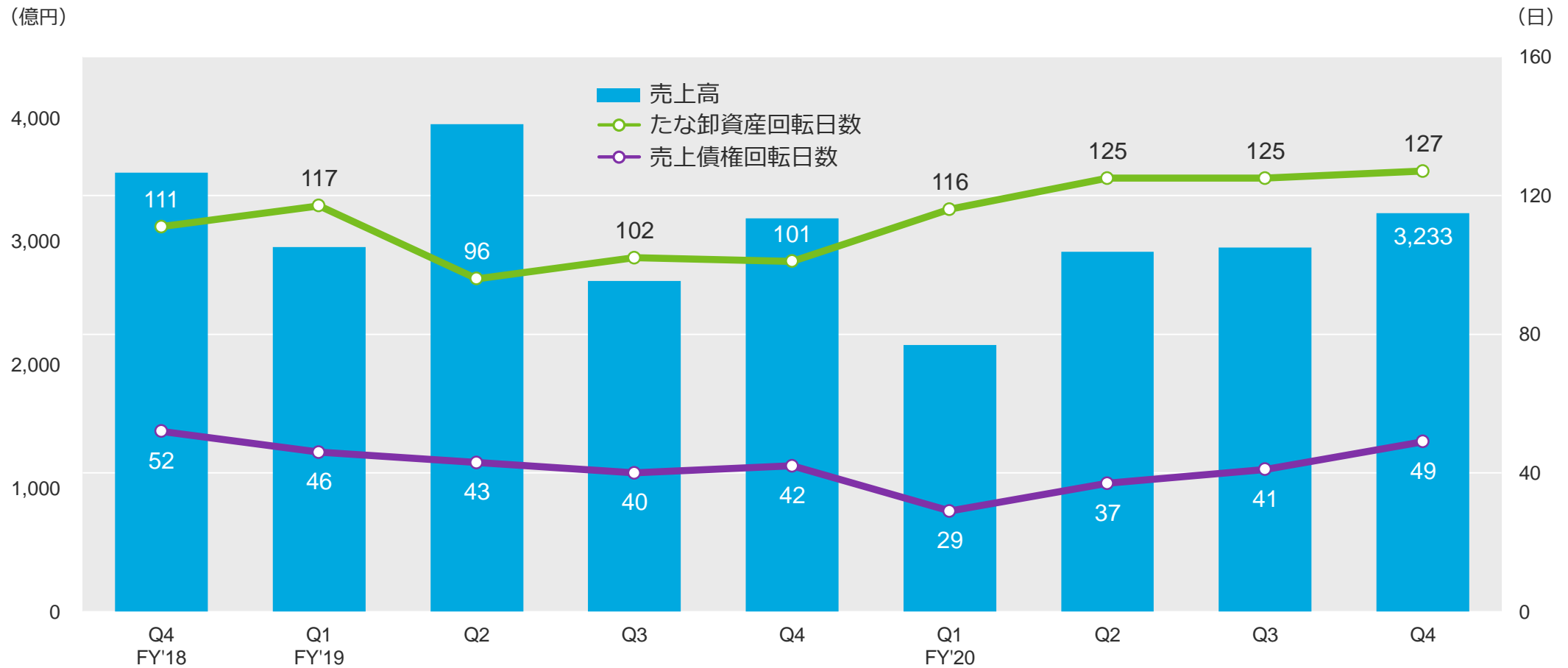


## 負債・純資産

(億円)

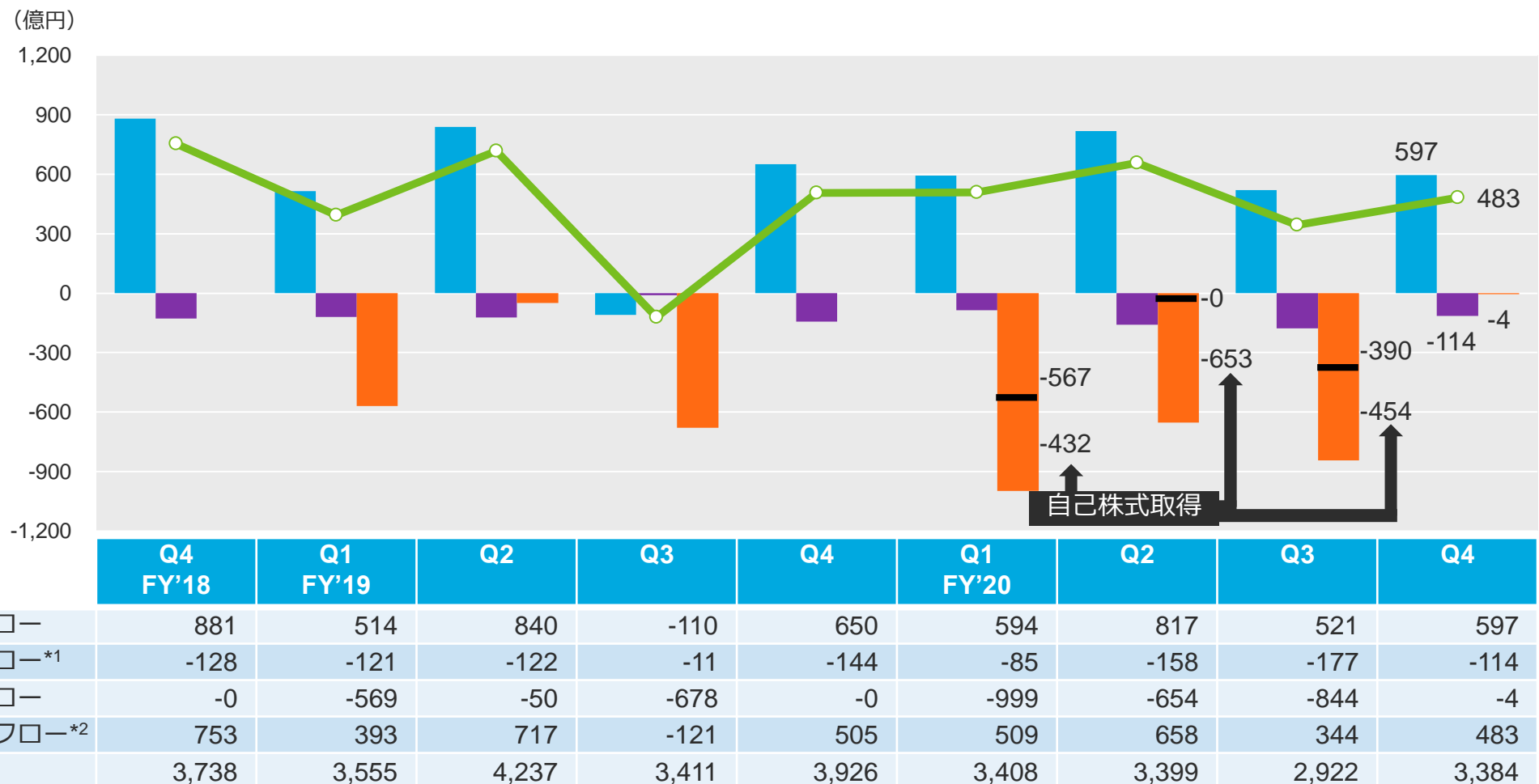


# たな卸資産・売上債権の回転日数（四半期）



回転日数 = 売上債権もしくはたな卸資産 ÷ 各四半期末までの12ヶ月間売上高 × 365

# キャッシュ・フロー（四半期）



\*1 投資キャッシュ・フローは、満期3ヶ月超の預金等の増減額を除いた金額です。

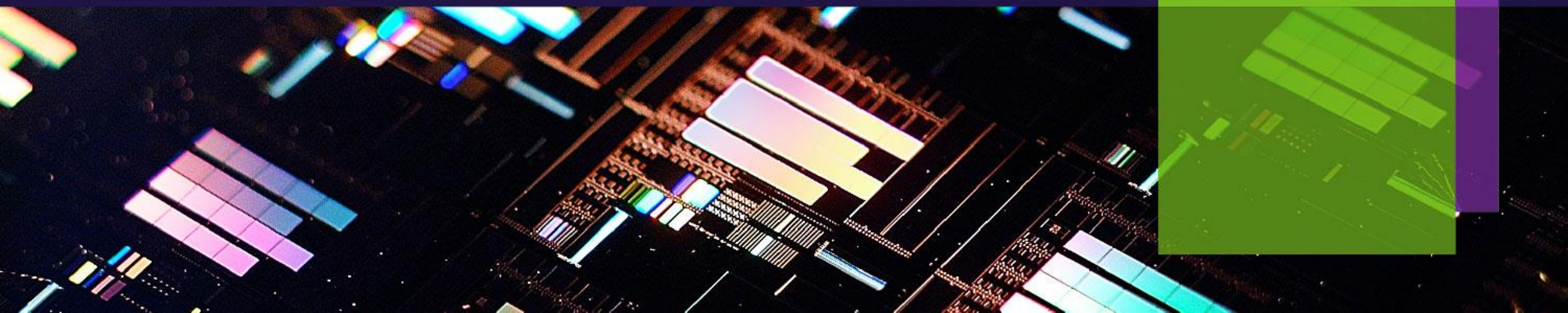
\*2 フリーキャッシュ・フロー = 営業活動によるキャッシュ・フロー + 投資活動によるキャッシュ・フロー（満期3ヶ月超の預金等の増減額を除く）

\*3 手元資金とは、現金及び現金同等物と満期3ヶ月超の預金等の合計金額です。

# 事業環境

2020年4月30日

河合 利樹  
代表取締役社長・CEO



## FY2020 事業ハイライト

- 業績は予想を上回って着地。売上、利益とも目標を達成
  - SPEの事業戦略は計画通り進捗、注力分野でのPOR獲得が続く
  - 有機ELディスプレイ製造用インクジェット描画装置 Elius™の受注拡大、採用に向けた評価が進む
  - フィールドソリューションが堅調に推移し、前期比増加
  - 半導体およびFPD製造装置市場の調整局面においても、研究開発投資、設備投資を前期から増額



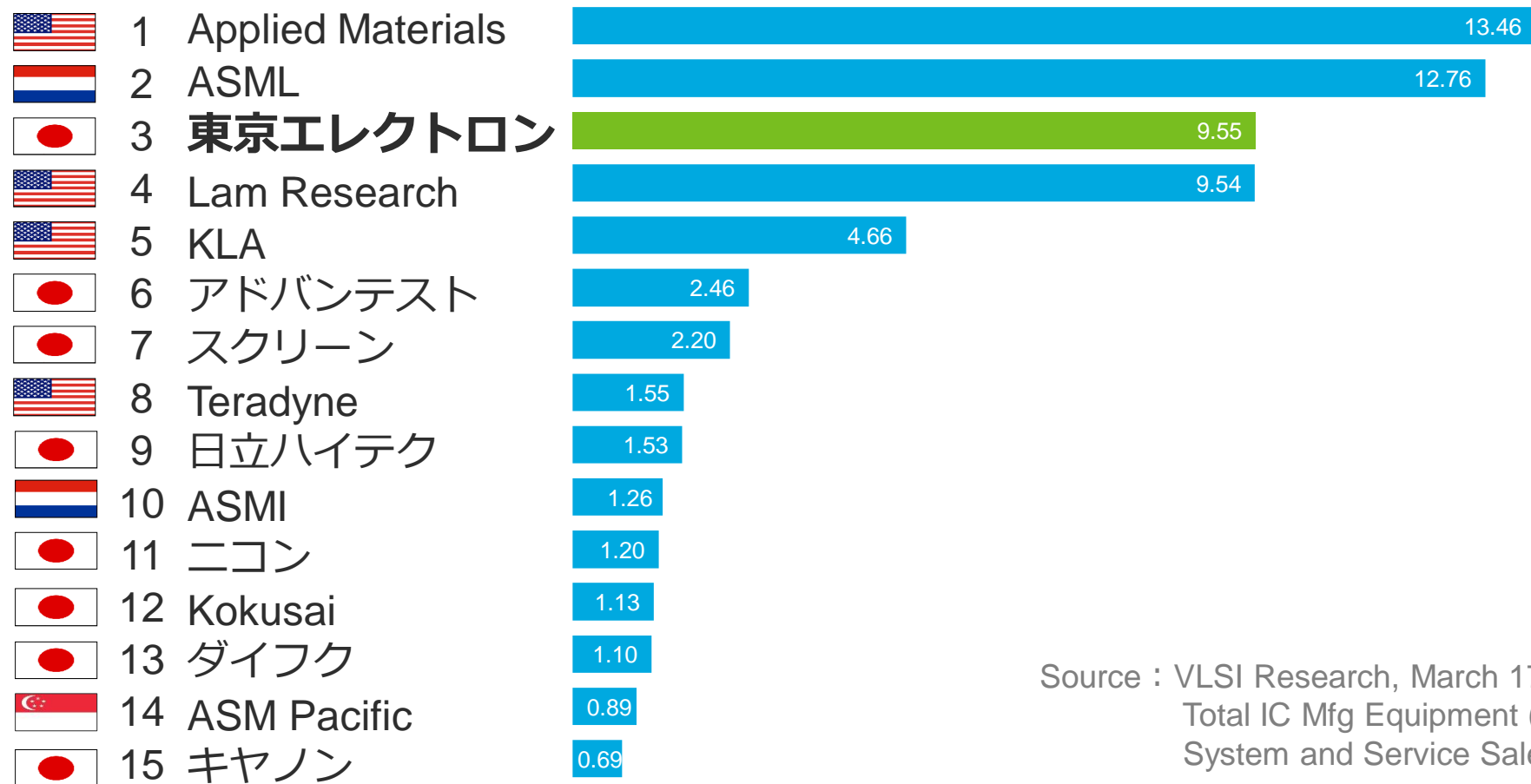
## CY2019 事業環境

- CY2019 WFE市場はメモリ向け投資が調整されるも、ロジック/ファウンドリ向け投資が増加。WFE全体の投資額は予想を上回り、前年比8%の減少に留まる
  - ロジック/ファウンドリ：前年比50%程度の増加。先端世代への投資が加速
  - 不揮発性メモリ：前年比45%程度の減少。前年から減少も、年末頃から回復に転じる
  - DRAM：前年比40%程度の減少。一方、年末にDRAM価格が下げ止まる
- CY2019 FPD製造装置市場は前年比25%減少も、年後半からOLED向け投資にけん引され回復基調

# 半導体製造装置メーカー トップ15

## CY2019 売上

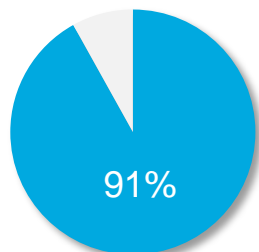
(Billions of US\$)



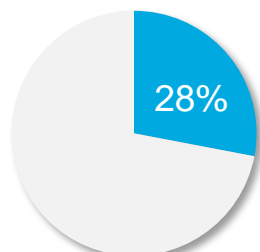
Source : VLSI Research, March 17, 2020,  
Total IC Mfg Equipment (Preliminary)  
System and Service Sales

# TEL 主要プロダクト 世界市場シェア (CY2019)

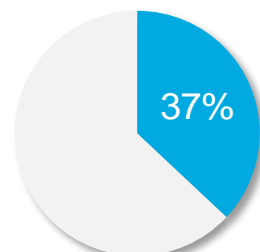
## 半導体製造装置



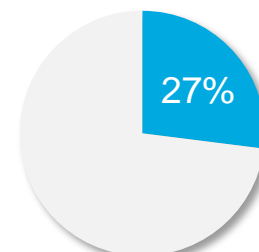
コータ/デベロッパ



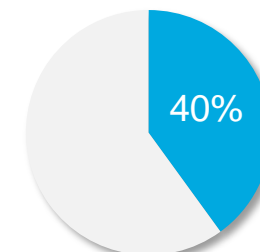
ドライエッチング装置



成膜装置

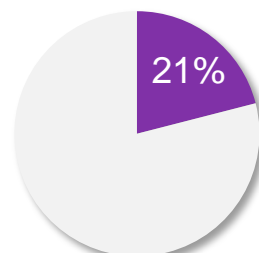


洗浄装置



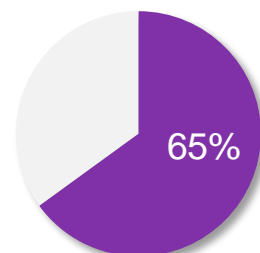
ウェーハプローバ\*

## FPD製造装置 (FY2020)

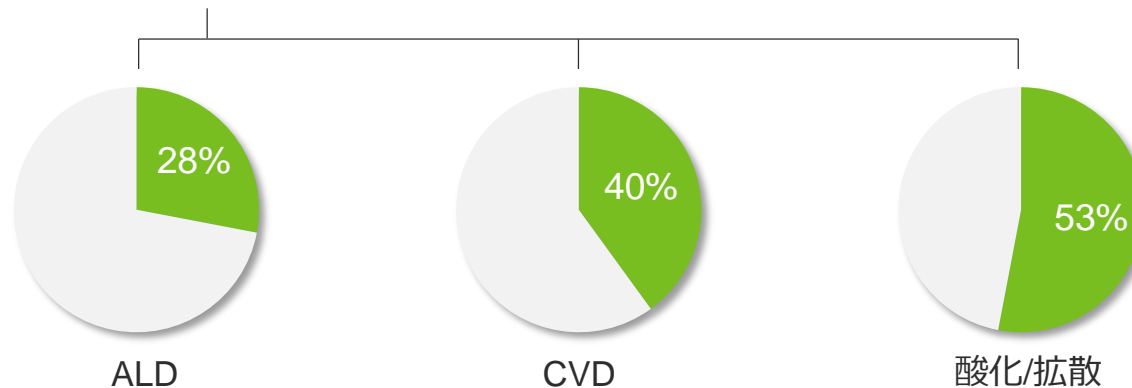


FPDコータ/デベロッパ

出所 (FPD) : 当社推定



FPDプラズマエッチング装置



出所

SPE (ウェーハプローバを除く) : Gartner, "Market Share: Semiconductor Wafer Fab Equipment, Worldwide, 2019", Bob Johnson, Gaurav Gupta, 14 April 2020  
 図はガートナーリサーチに基づき、東京エレクトロンが作成。

コータ/デベロッパ: Photoresist processing (Track), ドライエッチング装置: Dry etch, 成膜装置: Tube CVD + Atomic layer deposition tools + Oxidation/ Diffusion Furnaces + Nontube LPCVD, ALD: Atomic layer deposition tools, CVD: Tube CVD + Nontube LPCVD, 酸化/拡散: Oxidation/diffusion Furnaces, 洗浄装置: Single Wafer Processors + Wet stations +Batch Spray processors + Other clean Equipment

\* SPE (ウェーハプローバ) : VLSI Research, April 2020

図はVLSI Researchに基づき、東京エレクトロンが作成。

# 新型コロナウイルス（COVID-19）への対応（2020年4月時点）

- 生産体制・部品調達
  - シフト制、動線分離、在宅勤務を併用し、最大限の感染防止策を講じる
  - 工場の稼動と部品調達は計画通り進行
- 装置出荷・部品供給体制
  - 装置出荷への影響は軽微
  - 部品の安定供給を維持。現地法人の在庫の適正化
- 装置設置・顧客サポート
  - 現地従業員・駐在員で対応
- その他、事業所の対応
  - TELグループ全拠点を対象に在宅勤務を実施（赤坂・府中・大阪は原則在宅勤務）

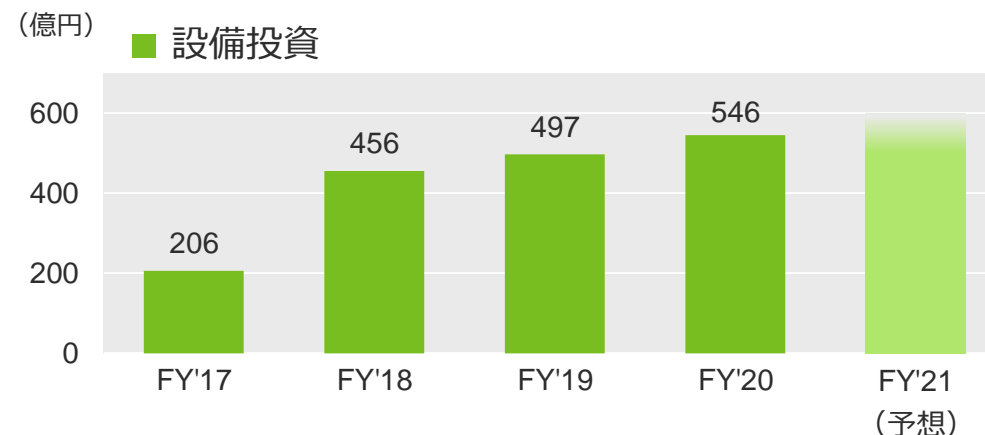
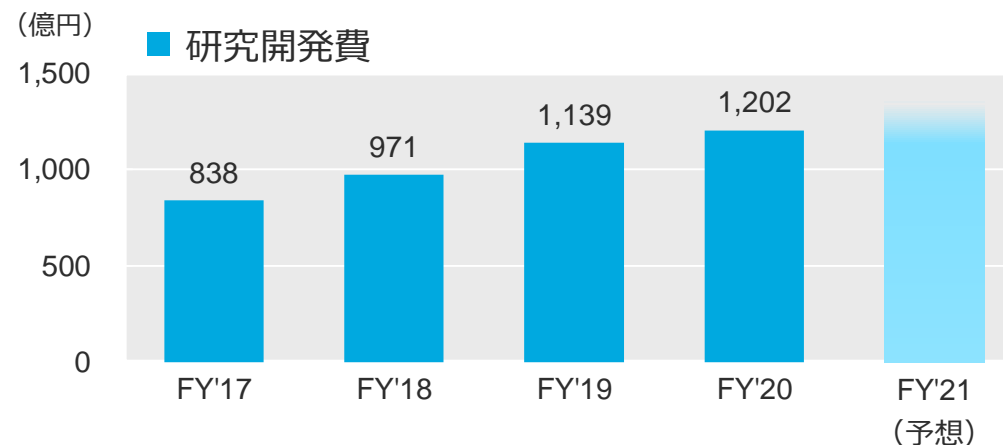
状況に応じた機動的な対応を継続

## FY2021 業績予想について

- データトラフィック増加にともない、データセンターおよび5Gスマートフォン向けの半導体需要が旺盛。堅調なロジック/ファウンドリ投資とともに、メモリ投資も回復。現状で顧客の投資計画に大きな変更はない
- 業績予想は、COVID-19のマクロ経済への影響を考慮し、適切なタイミングで開示すべきと判断

# FY2021 研究開発費・設備投資計画

- 開発費 1,350億円程度の規模を想定
  - 注力分野および持続的成長を見据えた投資継続
- 設備投資 560億円程度の規模を想定
  - 先端技術開発・増産対応への積極的な投資



## 新生産棟の建設

(成膜装置・ガスケミカルエッチング装置・テストシステム)



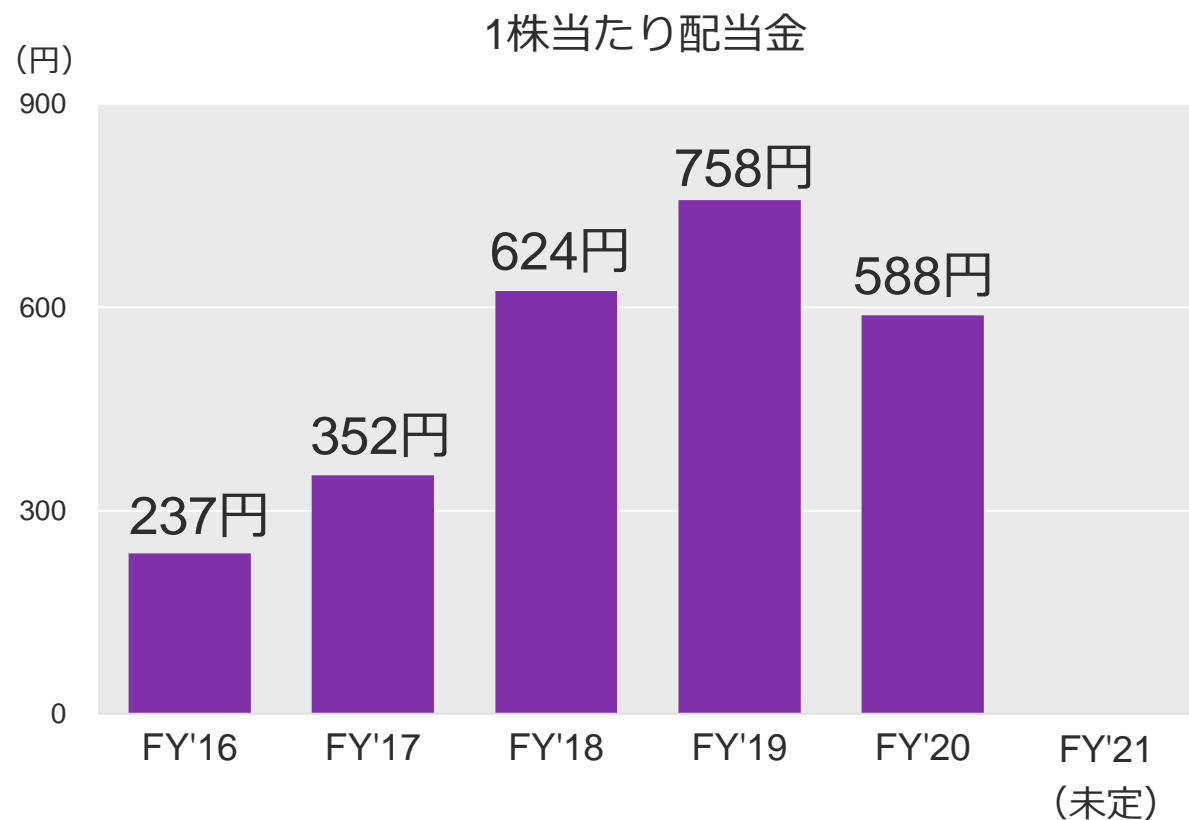
山梨県富士川町：建設費約130億円  
(2020年8月 稼動開始予定)



岩手県奥州市：建設費約130億円  
(2020年7月 稼動開始予定)

WFE市場の成長に向けて積極的な研究開発投資、設備投資を継続

# FY2021 配当予想について



## 当社の株主還元策

連結配当性向： 50%

但し、1株当たり年間配当金150円を下回らない

2期連続して当期利益を生まなかった場合は、配当金の見直しを検討する

自己株式の取得： 機動的に実施を検討

FY2020 配当金は予想を上回った  
FY2021 配当予想は、業績予想発表と同時に開示予定

# 中期経営計画

(億円)

| WFE market  | FY2020<br>(Actual) | By FY2024<br>(Plan) |          |          |
|-------------|--------------------|---------------------|----------|----------|
|             | \$54B              | \$55~60B            | \$60~65B | \$65~70B |
| 売上高         | 11,272             | 15,000              | 17,000   | 20,000   |
| SPE         | 10,609             | --                  | --       | --       |
| FPD         | 660                | --                  | --       | --       |
| 売上総利益       | 4,519              | 6,500               | 7,400    | 8,900    |
| 下段：売上総利益率   | 40.1%              | 43.3%               | 43.5%    | 44.5%    |
| 販管費         | 2,146              | 2,520               | 2,640    | 2,900    |
| 下段：売上高販管費比率 | 19.1%              | 16.8%               | 15.5%    | 14.5%    |
| 営業利益        | 2,372              | 3,980               | 4,760    | >6,000   |
| 下段：営業利益率    | 21.0%              | 26.5%               | 28.0%    | >30.0%   |
| ROE         | 21.8%              | >30%                |          |          |

財務モデルに変更なし  
 COVID-19に伴い本年は中期経営計画説明会を見送り



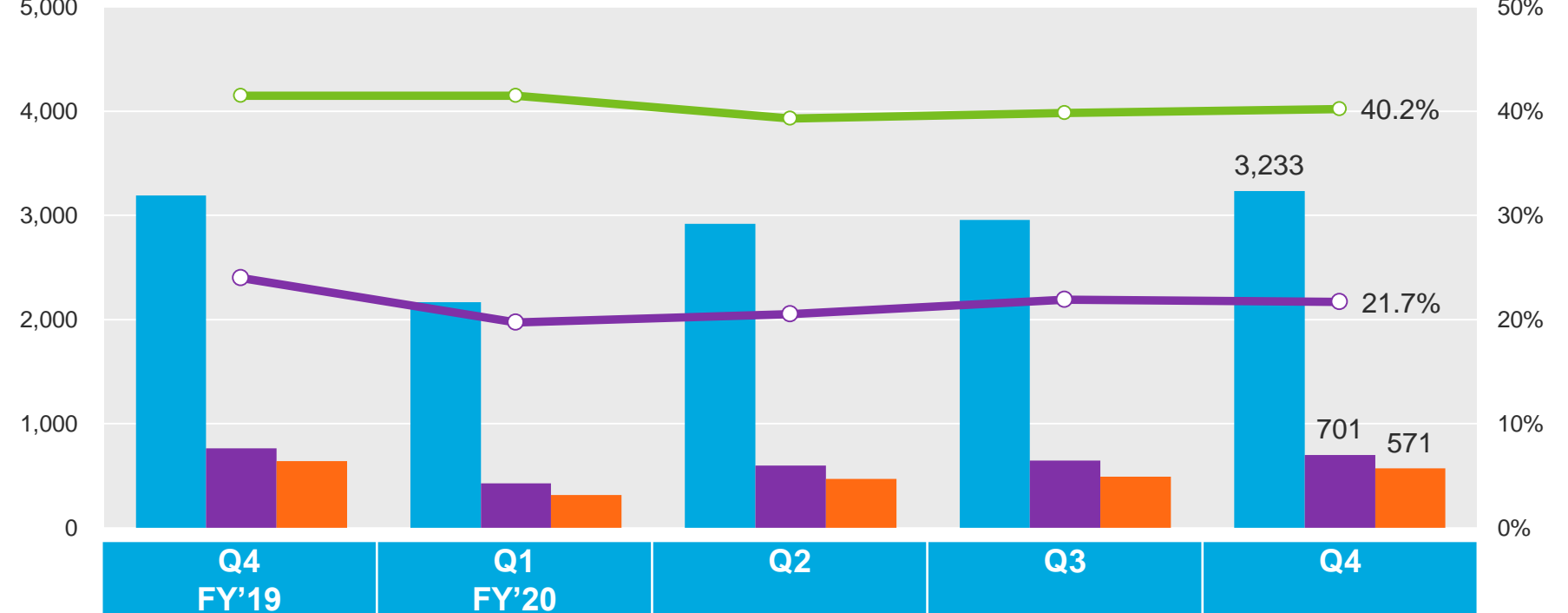
## 市場展望と企業価値向上

- 堅調なロジック/ファウンドリ投資とともに、メモリ投資も回復。COVID-19の影響は注視するも、旺盛な装置需要は継続すると予想
- さらに、IoT、AI、5Gに加えて、テレワーク、オンライン授業、遠隔診療などの積極的な利用が進み、データ社会への移行が加速。今後も半導体およびFPD製造装置が不可欠であり、中長期的な市場拡大を見込む
- 当社の有する革新的かつ多様な技術を融合し、ベストプロダクト、ベストサービスを提供することで、企業価値の向上を図るとともに夢のある社会の発展に貢献する

# 補足資料

# 損益状況 (四半期)

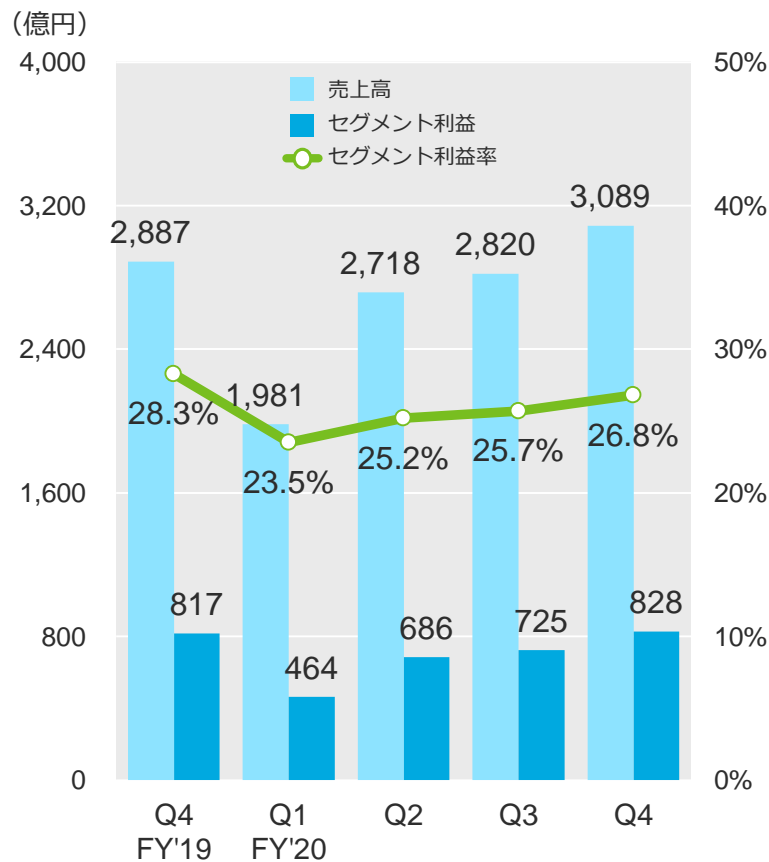
(億円)  
5,000



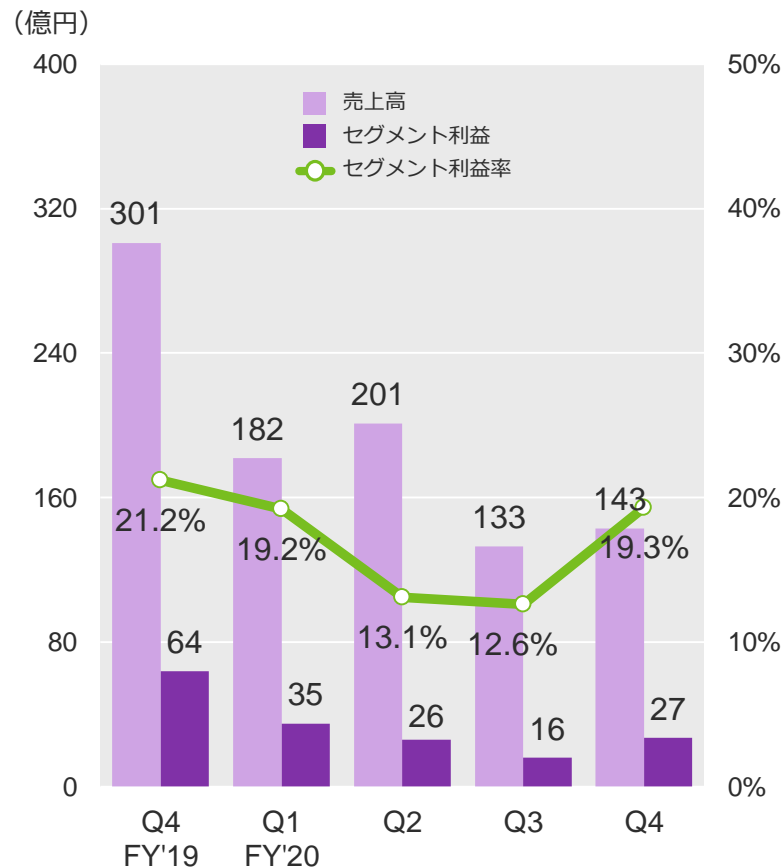
|                       |       |       |       |       |       |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ■ 売上高                 | 3,190 | 2,164 | 2,920 | 2,954 | 3,233 |
| ■ 営業利益                | 764   | 425   | 599   | 647   | 701   |
| ■ 親会社株主に帰属する<br>当期純利益 | 641   | 318   | 468   | 493   | 571   |
| ○ 売上総利益率              | 41.5% | 41.5% | 39.3% | 39.8% | 40.2% |
| ○ 営業利益率               | 24.0% | 19.7% | 20.5% | 21.9% | 21.7% |

# セグメント情報（四半期）

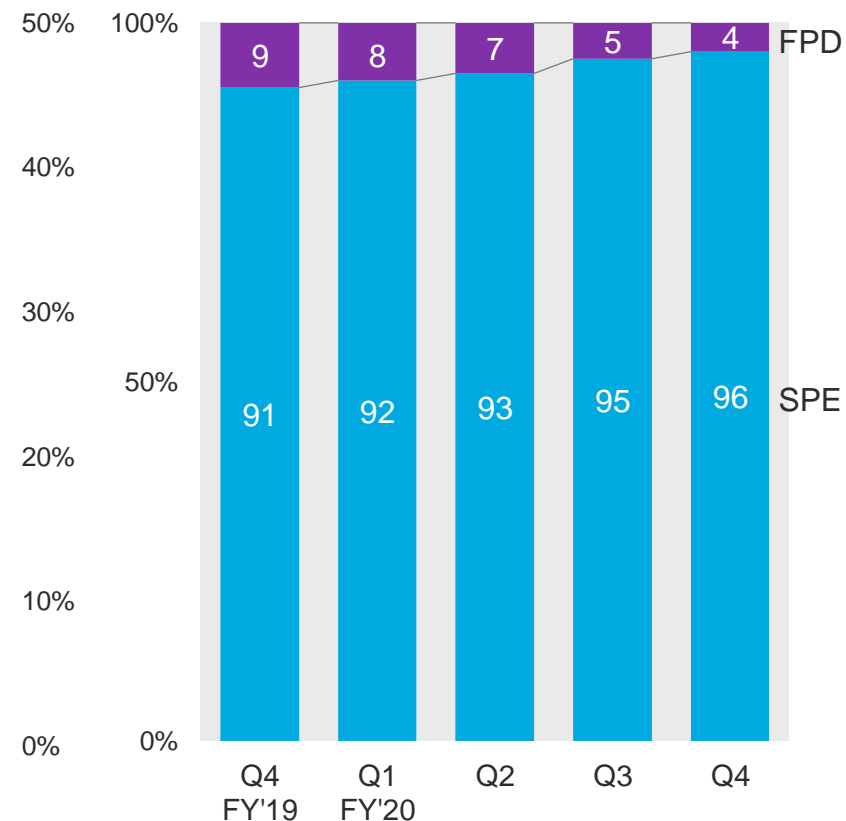
## SPE（半導体製造装置）



## FPD（フラットパネルディスプレイ製造装置）



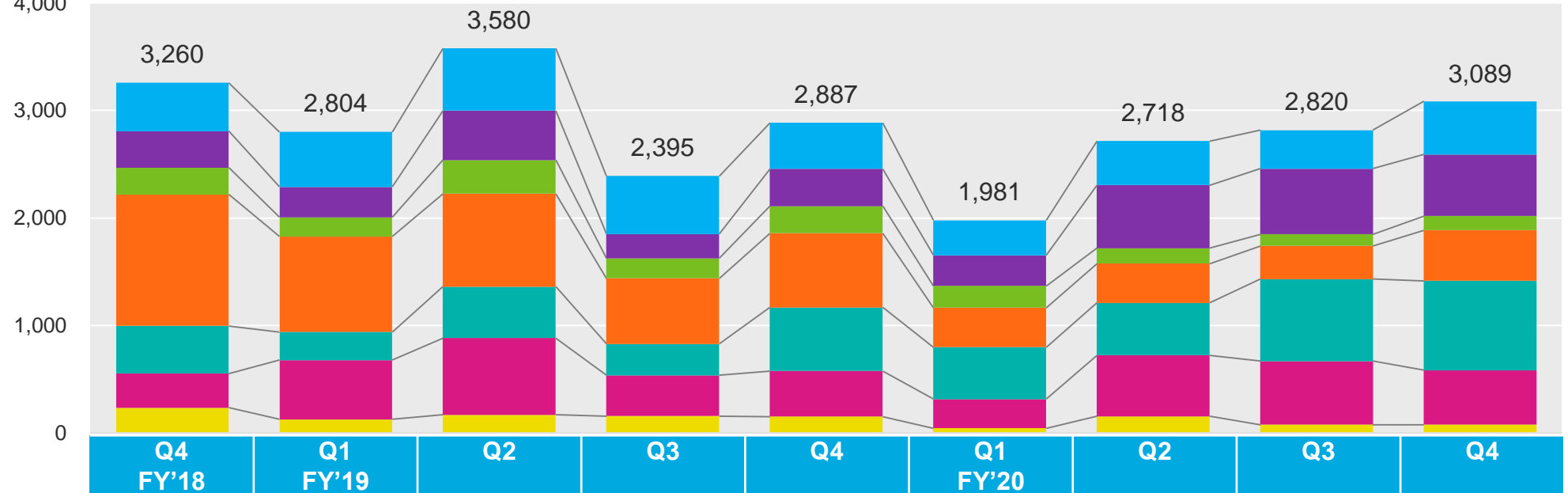
## 売上構成比率



1. セグメント利益は、税金等調整前当期純利益です。
2. 上記報告セグメントに配分していない基礎研究または要素研究等の研究開発費、およびその他の一般管理費等があります。
3. 売上構成比率は外部顧客に対する売上高で算出しています。

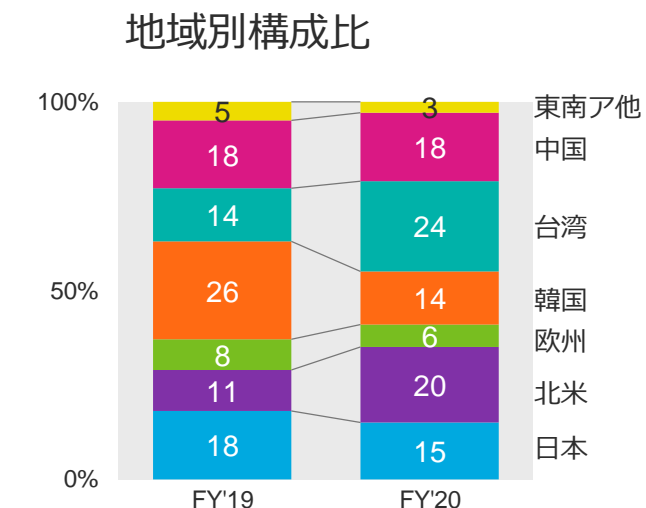
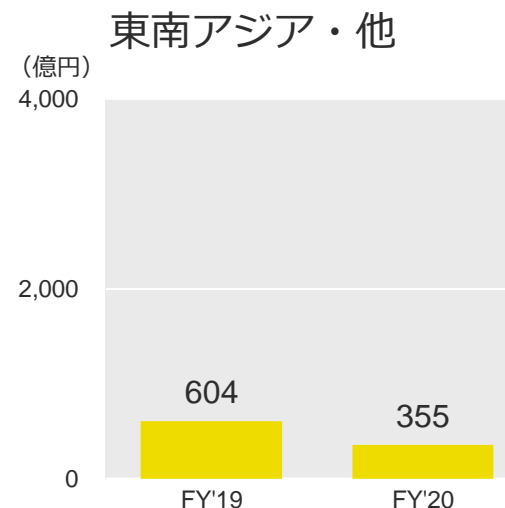
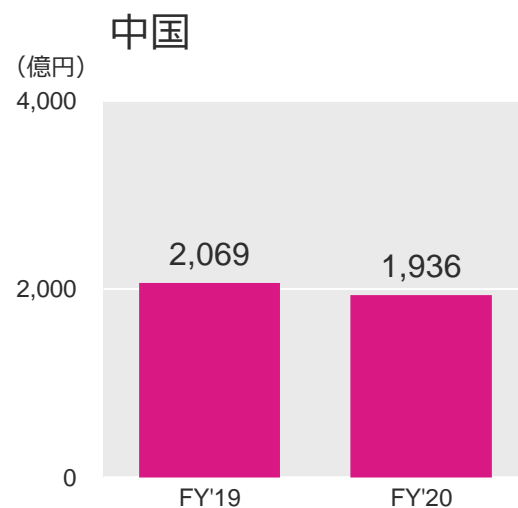
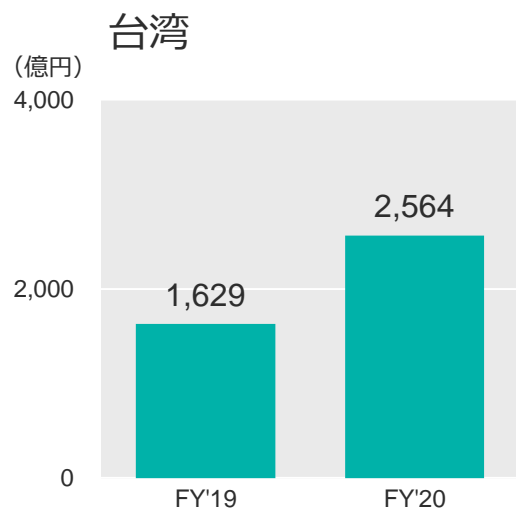
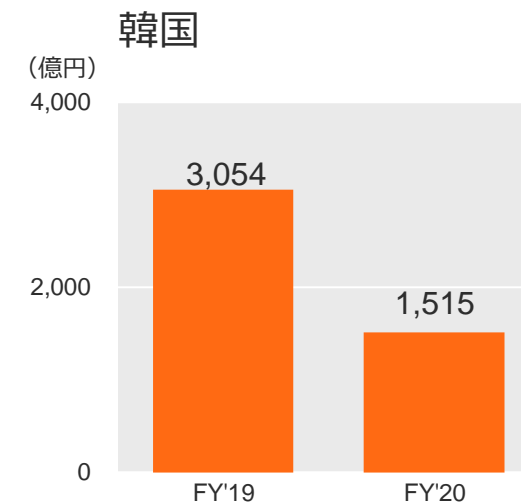
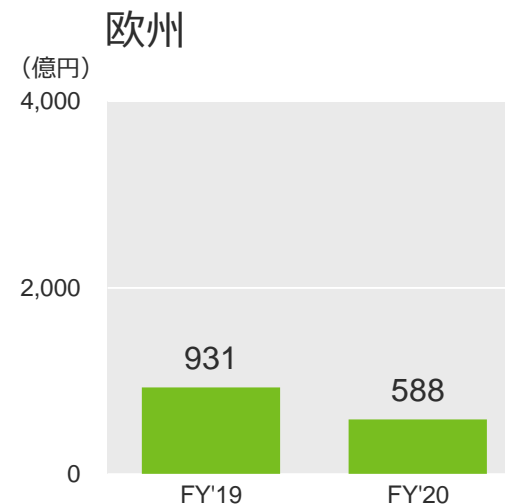
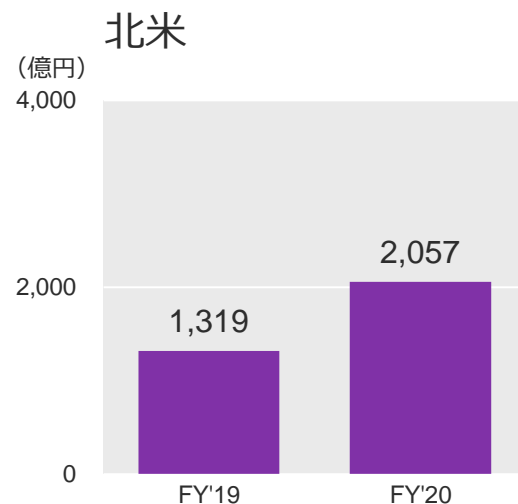
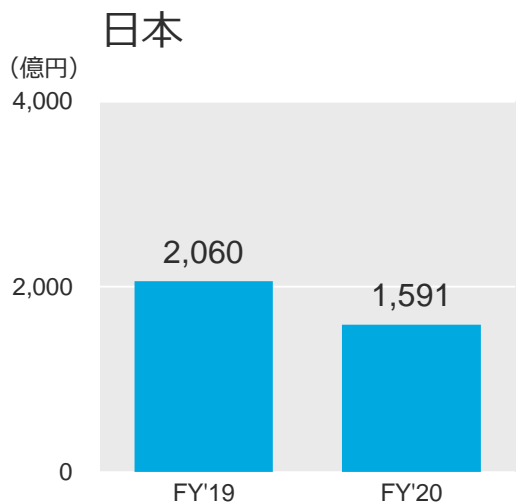
# SPE部門 地域別売上高 (四半期)

(億円)  
4,000

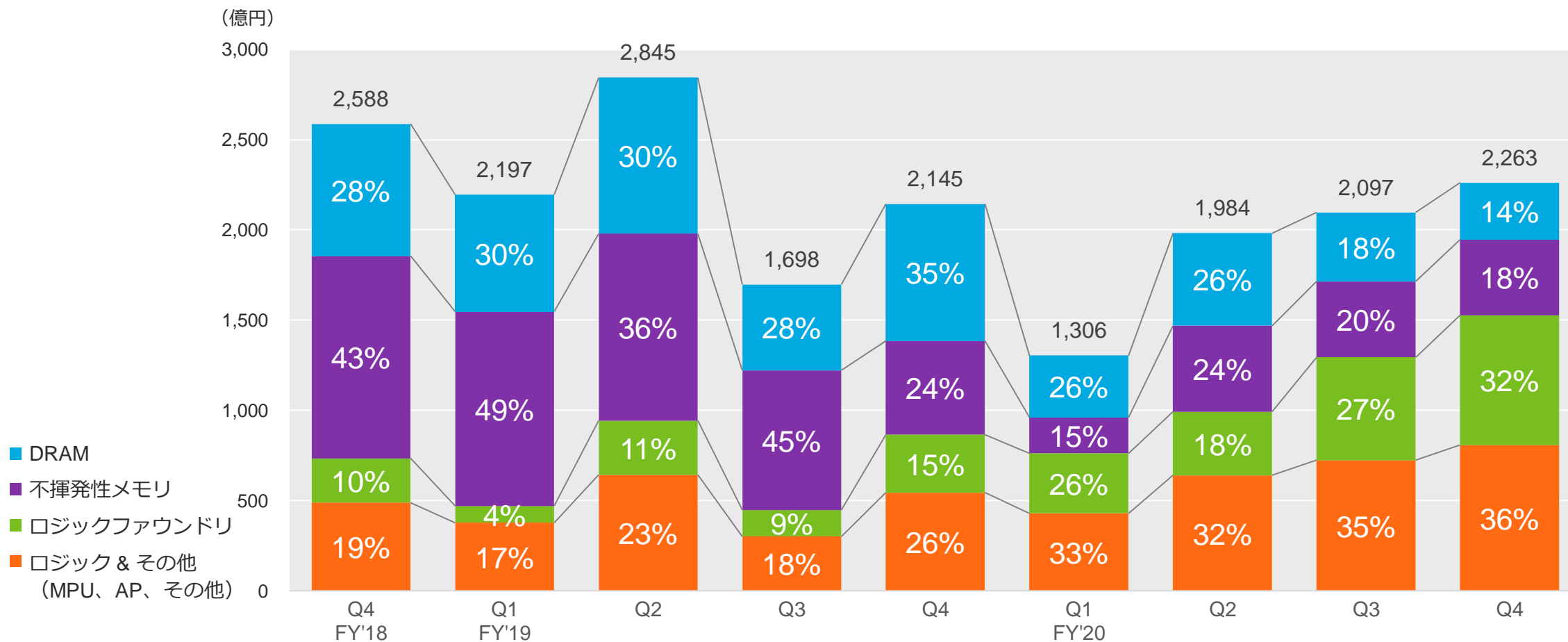


|         | Q4 FY'18 | Q1 FY'19 | Q2  | Q3  | Q4  | Q1 FY'20 | Q2  | Q3  | Q4  |
|---------|----------|----------|-----|-----|-----|----------|-----|-----|-----|
| 日本      | 451      | 511      | 580 | 540 | 427 | 325      | 410 | 359 | 496 |
| 北米      | 339      | 284      | 459 | 227 | 347 | 285      | 588 | 610 | 572 |
| 欧州      | 250      | 177      | 313 | 186 | 253 | 202      | 144 | 108 | 133 |
| 韓国      | 1,223    | 889      | 865 | 609 | 689 | 369      | 364 | 310 | 471 |
| 台湾      | 443      | 263      | 480 | 293 | 591 | 483      | 487 | 762 | 831 |
| 中国      | 318      | 549      | 713 | 380 | 425 | 270      | 568 | 591 | 506 |
| 東南アジア・他 | 234      | 127      | 168 | 156 | 152 | 44       | 155 | 77  | 77  |

# SPE部門 地域別売上高

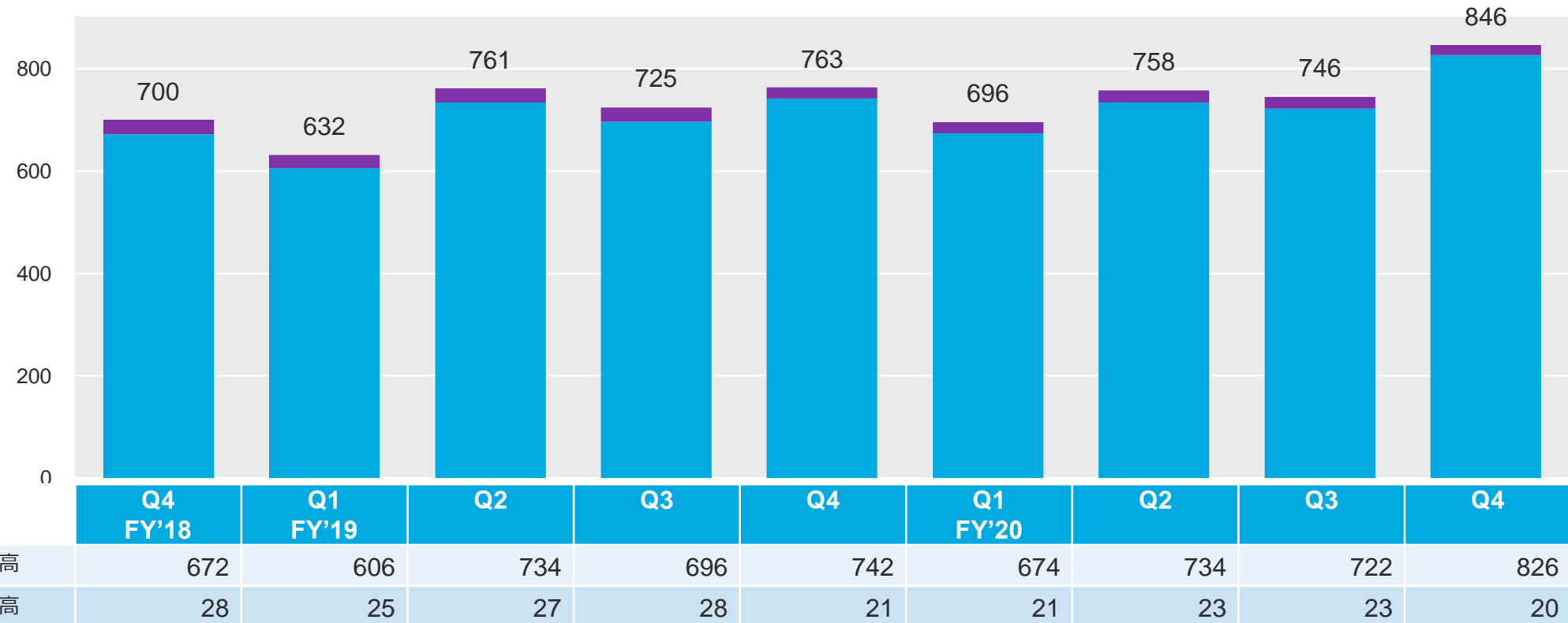


# SPE部門 新規装置 アプリケーション別売上構成比（四半期）



# フィールドソリューション売上高（四半期）

(億円)





**TEL**™

**TOKYO ELECTRON**